

表面安装品

■推荐焊盘尺寸

● 导电性高分子铝固体电解电容器

尺寸	X	Y	a
φ4	1.6	2.6	1.0
φ5	1.6	3.0	1.4
φ6.3	1.6	3.5	2.1
φ8	2.0	3.5	3.0
φ10	2.0	4.0	4.0

※FPCAP的推荐焊盘尺寸请参照第23页。

● 导电性高分子铝固体电解电容器抗振结构品 (PCX、PCR)

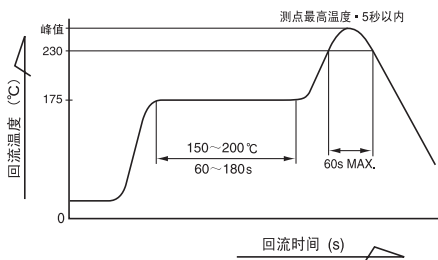
尺寸	X	Y	a
φ6.3×8L	3.0	4.0	1.6
φ8×10.5L	4.3	5.3	2.0
φ10×10.5L	4.3	5.6	3.3

● 导电性高分子混合动力铝电解电容器 (GYA)

尺寸	X	Y	a
φ6.3	1.6	3.5	1.9
φ8	2.5	3.5	3.0
φ10	2.5	4.0	4.0

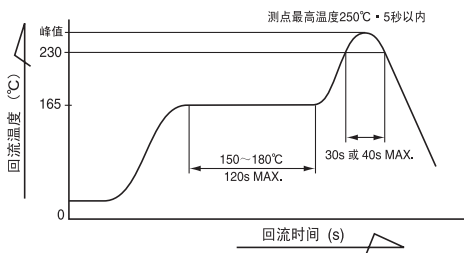
■回流 (IR、热风炉) 焊接

●图-1 芯片型导电性高分子铝固体电解电容器※ (PCF、PCJ、PCK、PCG、PCS、PCV、PCX、PCR)



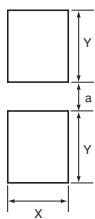
- 预热为150~200°C、60~180秒以内。
 - 电容器表面温度超过230°C的时间为60秒以内。
 - 温度分布图的温度标准因回流方式不同而不同。
 - 峰值温度260°C以下时，回流次数仅为1次。
 - 峰值温度250°C以下时，回流次数最多2次。但在第1次和第2次之间要留出充分的产品冷却时间。
 - 电容器表面的温度不可超过最高温度。
 - 超出容许范围使用时请咨询我们。
- ※FPCAP的焊接条件请参照第23页。

●图-2 导电性高分子混合动力铝电解电容器 (GYA)



- 预热为150~180°C、120秒以内。
- 峰值温度260°C MAX.时，回流次数仅为1次，超过230°C的时间为40秒以内。
- 峰值温度250°C MAX.时，回流次数最多为2次，超过230°C的时间为30秒以内。但在第1次和第2次之间要留出充分的产品冷却时间。
- 超出容许范围使用时请咨询我们。

■推荐焊盘尺寸



●导电性高分子品 (FPCAP)

RPS, RPA, RHS, RHA, RSS, RSA, RSB, RFS, RFA, RSL (mm)

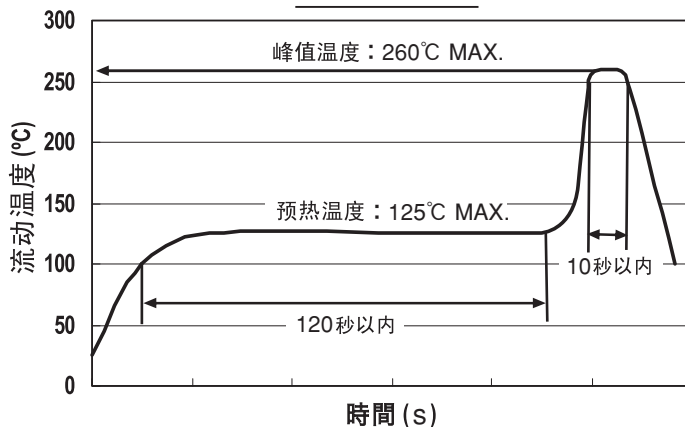
尺寸	X	Y	a
FPCAP φ4	1.6	2.6	1.0
φ5	1.6	3.0	1.4
φ6.3	1.6	3.5	2.1
φ8	1.9	4.2	2.8
φ10	1.9	4.4	4.3

无铅及RoHS指令适合焊接条件

流动焊 (引线型)

RNS, RR7, RR5, RL8, RE5, RS8, RF8, RNU, RNE, RNL, RS6, RHT

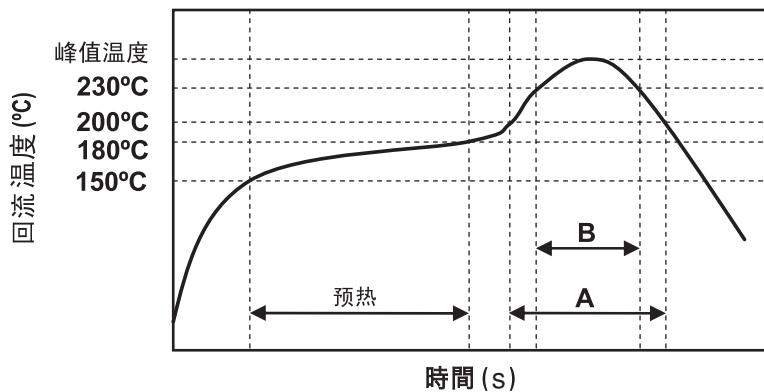
推荐流动条件



回流焊 (芯片型)

RPS, RPA, RHS, RHA, RSS, RSA, RSB, RFS, RFA, RSL

推荐回流焊条件



項目	推奨条件 1	推奨条件 2
峰值温度	260°C MAX.	250°C MAX.
预热	150~180°C 90秒以内	150~180°C 90秒以内
A	200°C以上 60秒以内	200°C以上 60秒以内
B	230°C以上 40秒以内	230°C以上 40秒以内
回流次数	1次	2次以下